

证券代码：002618

证券简称：丹邦科技

公告编号：2017-024

深圳丹邦科技股份有限公司

关于微电子级PI膜产品获得科学技术成果鉴定证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司广东丹邦科技有限公司联合研制的“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目于2017年1月13日通过了经深圳市科技创新委员会授权，深圳市高新技术产业协会主持的科技成果鉴定会，详细内容参见公司于2017年1月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

近日，公司收到本项目的《科学技术成果鉴定证书》（深科同鉴字[2017]第1014号）并完成该项目的科学技术研究成果登记，获得科学技术研究成果《登记证书》（登记号：2017Y0014），鉴定结论如下：

1、丹邦科技研制的高性能聚酰亚胺薄膜，通过对聚酰亚胺分子结构优化设计，引入官能团，提高了产品性能；开发了聚酰胺酸（PAA）的低温化学酰亚胺化工艺；发展了喷涂-双向拉伸法生产超薄聚酰亚胺薄膜技术，提高了薄膜平整性和力学性能。该项成果经客户试用，预计将产生良好的经济效益与社会效益、具备产业推广应用条件。

2、产品主要性能通过第三方检测单位的检测，聚酰亚胺薄膜厚度最薄6微米，介电强度、热/吸湿膨胀系数、拉伸强度等指标达到或优于国际同类产品水平。产品综合性能达到国际先进水平，填补国内空白。

3、建议尽早实现该成果的产业化生产，为我国微电子行业的发展做出更大的贡献，一致同意通过科技成果鉴定。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2017年6月13日